

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2026-015

## 联芸科技（杭州）股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额，并另行公告具体调整情况。

● 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4.61 亿元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 460,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,000,000

元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 16.18%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况如下：

项目	2025年度
现金分红总额（元）	23,000,000.00
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,158,465.39
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	461,416,315.57
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	23,000,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	142,158,465.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	23,000,000.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	是
现金分红比例（%）	16.18%
现金分红比例（E）是否低于30%	是
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	502,770,241.70
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,327,129,441.63
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	37.88
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：公司于 2024 年 11 月在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，根据

《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条“公司上市不满三个完整会计年度的，前款第八项所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度”，故上表中“最近三个会计年度”系指 2025 年度。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 142,158,465.39 元，2025 年度拟分配的现金红利总额为 23,000,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 16.18%，本年度现金分红比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。作为典型的技术与资本密集型行业，业内技术升级与产品迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。报告期内，公司研发投入约 5.03 亿元，占当年营业收入的比例为 37.88%。公司芯片产品的技术突破及产业化进程需要较大的研发投入，为保持公司在技术方面的竞争力，公司仍需维持较大规模的研发投入，以支撑产品持续迭代、丰富产品类型、保障供应能力，以应对下游客户多样化的需求和应对市场风险，维持市场竞争力。

由于公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路设计业务，将晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成。因此，委外加工、库存水平等需要较强的资金储备。

2025 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 142,158,465.39 元，同比增长 20.41%。2026 年，公司将继续加大研发投入和技术创新，在实现对原有产品的迭代优化和性能提升的同时，加速对新产品的研发及市场布局。因此，公司须预留足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司的平稳运营、健康发展，维护好公司价值，为股东和投资者创造更多回报。

（二）上市公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司 2025 年度留存未分配利润将累计滚存至下一年度，用于稳步推进各项业务计划实施落地，优先满足公司生产经营、研发创新等需求，从而实现公司价值的不断增长，最大限度维护股东利益。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

1、公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线及邮箱等多种方式来表达对利润分配的意见和诉求。

2、公司将在年度股东会就现金分红方案，通过现场会议及网络投票的方式实施中小股东表决情况单独计票并披露。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，努力提升自身经营业绩，在确保公司持续、稳定发展的前提下，切实提升投资者回报水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月9日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### 四、相关风险提示

(一)公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营、未来的资金需求等情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年4月10日